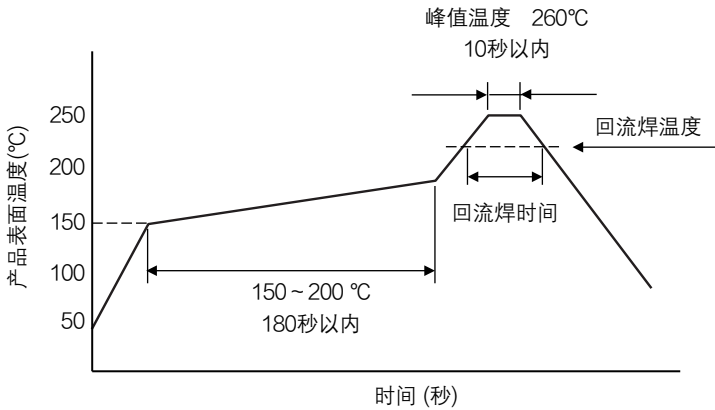


贴装规格

● 锡焊推荐条件



回流焊在下列回流焊条件下至多3次。

回流焊温度和时间

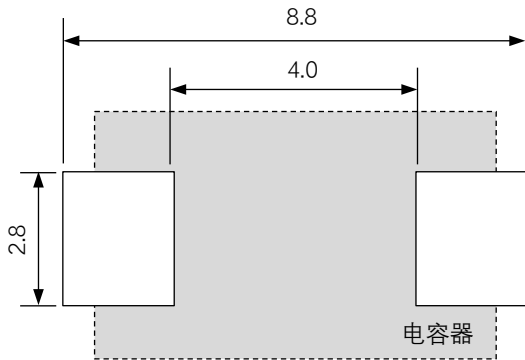
| 温度 | 时间 |
|---------|---------|
| 255°C以上 | 30 秒以内 |
| 230°C以上 | 130 秒以内 |
| 217°C以上 | 150 秒以内 |

回流焊满足
IPC/J-STD-020F 符合

● 参考焊盘尺寸

□ 2端子产品

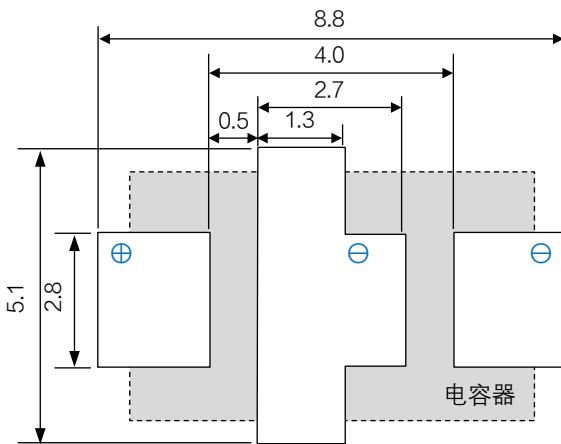
标准端子形状用 (C*, S*, G*, J*, K*, T*, HX 系列)



单位:mm

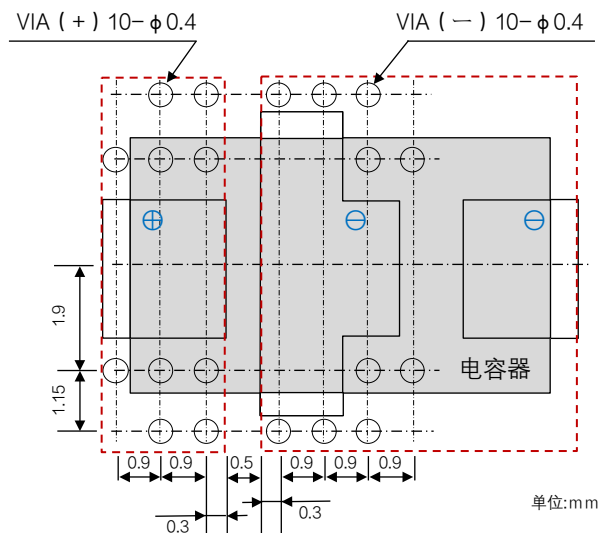
□ 3端子产品

用于低ESL端子形状 (L*, GX-L 系列)



〈VIA盘尺寸〉

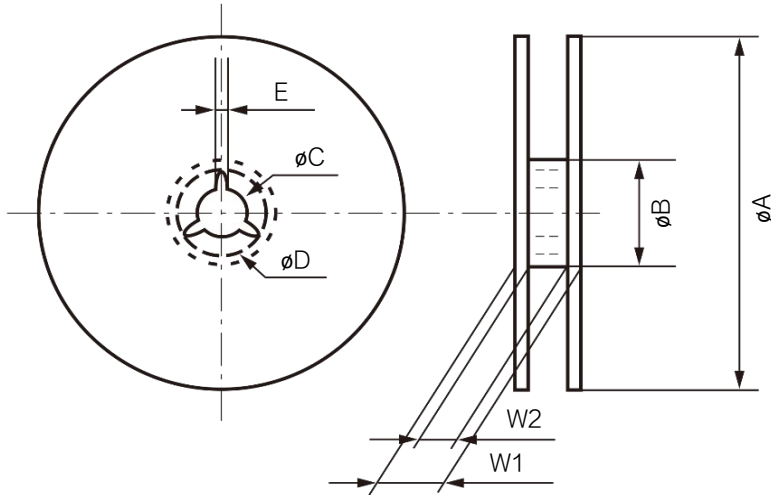
用于低ESL端子形状 (L*, GX-L 系列)



单位:mm

包装规格

● 带状包装用卷盘

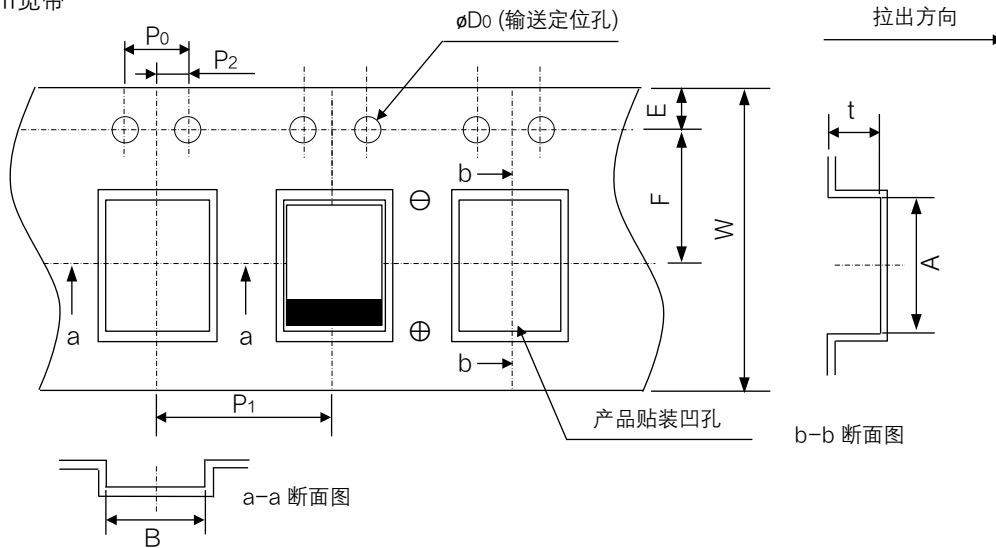


单位:mm

| 卷盘 | ϕA | ϕB | ϕC | ϕD | E | W1 | W2 |
|------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| $\phi 330$ | 330 ± 2 | 80 ± 1 | 13 ± 0.2 | 21 ± 0.8 | 2 ± 0.5 | 17.5 ± 1 | 13.5 ± 1 |

● 模压带包装

12mm宽带

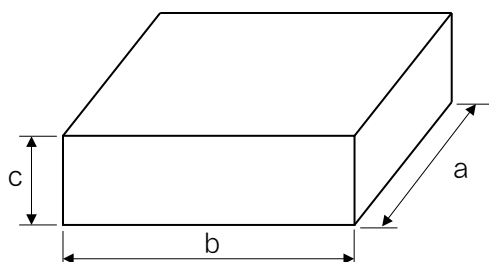


单位:mm

| A | B | W | F | E | P1 | P2 | P0 |
|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 7.6 ± 0.2 | 4.5 ± 0.2 | 12 ± 0.3 | 5.5 ± 0.1 | 1.75 ± 0.1 | 8.0 ± 0.1 | 2.0 ± 0.1 | 4.0 ± 0.1 |

| ϕD_0 | 上行: 产品高度(mm) / 下行: t | | | |
|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | ~ 1.1 | 1.4 ~ 1.9 | 2.2 | 2.8 |
| $1.5 \begin{smallmatrix} +0.1 \\ 0 \end{smallmatrix}$ | 1.5 ± 0.2 | 2.4 ± 0.2 | 2.9 ± 0.2 | 3.5 ± 0.2 |

● 包装箱外观尺寸



单位:mm

| 卷盘 | a | b | c |
|------------|----------|----------|----------|
| $\phi 330$ | 400 max. | 400 max. | 135 max. |